

东方证券股份有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，负责德邦科技持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与德邦科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解德邦科技业务情况，对德邦科技开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2025 年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2025 年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2025 年上半年度，保荐机构督导德邦科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促德邦科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对德邦科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，德邦科技的内部控制制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促德邦科技依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不	保荐机构对德邦科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
	予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2025 年上半年度持续督导期间内，德邦科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年度持续督导期间内，德邦科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2025 年上半年度持续督导期间内，德邦科技未发生上述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	保荐机构制定了对德邦科技的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，德邦科技不存在需要进行专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）产品迭代与技术开发风险

公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。公司所处行业领域技术升级及产品更新迭代速度较快，且公司面临的竞争对手主要为国际知名企业。公司需要持续研发符合客户需求的新型产品，并与竞争对手展开技术

竞争，对公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术与行业新需求的匹配性构成一定挑战。

如果公司不能准确地把握下游行业的发展趋势，或者公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术无法满足客户对于新型封装工艺和应用场景的需求，或在与竞争对手的直接技术竞争中处于劣势，这将导致公司产品与下游客户的技术需求适配性下降，进而对公司的产品销售、业务开拓和盈利能力造成不利影响。

（二）关键技术人员流失风险

高端电子封装材料行业属于技术密集性行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。未来如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势，或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有关键技术人员流失的情形，进而对公司生产经营产生不利影响。

（三）核心技术泄密的风险

公司拥有多项与电子级粘合剂制备与功能性薄膜材料制程相关的核心技术，公司的主要研发竞争力在于产品配方的持续研发创新以及工艺流程的优化改进。若公司产品配方与工艺流程被复制或泄露，公司的市场竞争力将受到不利影响。

（四）经营风险

随着公司资产、业务、机构和人员等规模不断扩大，将在市场开拓、产品研发、制造能力、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。未来若公司的治理模式和经营水平未能及时根据内外部变化情况进行优化和提升，可能会对公司经营管理和经营业绩产生不利影响。

2025年上半年，公司营业收入为68,994.04万元，保持持续稳定增长。与国内外主要竞争对手相比，公司的经营规模相对较小，抵御经营风险的能力相对偏弱。公司当前业务经营能力仍相对有限，在市场销售、研发投入等方面仍有不足，面对日益增长的客户需求，可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会，导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。

（五）财务风险

1、毛利率波动风险

根据应用领域与场景的差异，公司产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料以及高端装备应用材料这四大类别。在报告期内，公司业务整体呈现出迅猛发展的态势。然而，不同类别产品的毛利率水平，主要受到行业现状、市场供求关系、产品技术特性、产品更新换代节奏以及公司销售与市场策略等多种因素的综合作用，进而存在一定差异。

鉴于公司各类产品所面临的市场竞争环境各不相同，产品所处的生命周期阶段和更新迭代进度也有所区别，销售结构存在差异，并且同一产品的单位成本金额持续受到原材料价格波动的影响，公司面临着因上述因素导致毛利率下降的风险。倘若公司无法依据市场变化及时推进产品技术升级，致使产品技术缺乏先进性，或者公司市场推广效果未达预期，造成高毛利产品销售增速减缓、收入占比降低，又或者原材料价格大幅上扬，都有可能致使公司毛利率水平进一步下滑，进而对公司的经营业绩与盈利能力产生负面影响。

2、汇率波动的风险

汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性，同时随着公司全球化布局的深入，公司产品进出口涉及美元及其他外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。随着公司境外相关业务规模的持续扩大，如果未来汇率出现大幅波动，公司将面临着一定的汇率风险导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

公司将加强资金筹划与管理，以防止汇率波动所带来的风险，同时也会密切关注汇率的波动和走势。及时掌握货币结算的政策和趋势，适时采取必要的措施，弱化汇率波动的风险，尽可能的降低汇率波动的不利影响。

3、应收账款无法按期收回的风险

随着公司销售规模不断增长，公司的应收账款余额可能将保持较大规模。报告期内，公司应收账款回收情况良好，如果公司主要客户的财务状况出现恶化，可能出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况，进而对公司资金周转和生产经营产生不利影响。

为此，公司坚持风险控制优先，不断强化应收账款管理和责任落实，定期梳理欠款项目，强化应收账款内控监督，形成全流程应收账款管理机制，确保应收账款风险得到有效控制，增强公司的现金流量能力，提高资金的使用效率。

4、税收优惠变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业、研发加计扣除等企业所得税优惠政策。如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获得税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响。

5、政府补助降低的风险

报告期内，公司计入损益的政府补助金额为 703.53 万元(包括增值税加计扣除金额)。如果未来政府部门对相关产业的政策支持力度减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

6、商誉减值风险

本报告期初商誉账面原值为 7,099,450.64 元，该商誉为本公司收购东莞德邦公司时形成。东莞德邦公司经营状况良好，目前不存在需要计提商誉减值准备的情况，如果未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。本报告期内公司完成了对泰吉诺公司股权收购的交割及并表，支付金额超过购买日公司享有的可辨认净资产公允价值份额，形成商誉 195,651,847.61 元。泰吉诺主要从事高端导热界面材料的研发、生产及销售，并主要应用于半导体集成电路封装领域，所处行业具有研发投入高、技术迭代快、研发周期长等特点，泰吉诺的经营效益受宏观政策、经济周期、市场竞争、经营管理等多种因素的影响，可能存在业绩不达预期的风险。如果未来由于行业不景气或泰吉诺自身因素导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

（六）行业风险

1、集成电路国产化进程放缓风险

集成电路封装材料行业的行业风险主要集中在技术迭代压力、供应链稳定性和市场竞争格局上。首先，随着先进封装技术的快速发展，材料性能要求不断提升，例如高精度基板需满足亚微米级线宽/线间距，新型粘接剂需适应细间距凸块工艺。国内企

业在高端材料，如ABF载板、车规级塑封料上仍依赖进口，国产化率不足10%，技术壁垒导致产品迭代滞后风险突出。其次，供应链稳定性受关键原材料进口依赖影响，美国关税政策调整虽豁免部分初级材料，但深加工产品仍面临高额关税，叠加地缘政治风险，可能引发供应中断。此外，全球封装基板市场高度集中，国际巨头占据主导地位，国内企业在高端市场份额不足，需应对技术封锁与价格竞争双重压力。

2、智能终端行业面临多重困难

智能终端封装材料行业潜在风险原材料价格受国际政治、市场波动等影响，上涨会增加成本；技术研发难度大、周期长，且迭代迅速，跟不上易被淘汰；市场竞争激烈，国际巨头占据高端，中低端价格战频发，客户认证也严苛；政策法规上，环保标准趋严，贸易摩擦不断，产品不达标或出口都可能面临困境，影响企业发展。

3、新能源行业竞争加剧风险

在新能源应用材料领域，行业风险主要体现在市场竞争与成本压力的双重挑战：一方面，随着新能源产业链快速扩张，赛道入局者增多，市场竞争日趋激烈，头部企业与中小厂商在技术研发、客户资源、产能规模等层面的较量加剧，部分企业为抢占份额采取低价策略，推动行业价格中枢下行，对产品毛利率形成挤压；另一方面，下游新能源汽车厂商受终端需求波动、库存调整等因素影响，对上游材料采购价格敏感度上升，叠加原材料价格波动传导效应，进一步加剧了胶粘剂产品的定价压力，行业整体面临“竞争升级+价格承压”的双重风险考验。

4、高端装备制造技术创新风险

在高端装备应用材料所涉及的工业MRO、轨道交通、汽车制造、电机等领域，行业风险主要体现在三方面：一是核心原材料价格受国际供应链波动、地缘政治等因素影响，存在阶段性上涨压力，可能推高生产成本；二是下游行业技术迭代加速，如新能源汽车电机高效化、轨道交通装备轻量化等趋势，对封装材料的耐高温、耐老化、导热性能提出更高要求，若技术研发与客户需求迭代不同步，可能面临产品竞争力下降风险；三是市场竞争呈现分层态势，国际巨头凭借技术积累和品牌优势占据高端市场，国内部分企业在中低端领域以价格竞争抢占份额，同时下游客户对供应商认证标准严苛、周期较长，新进入者或中小厂商拓展市场难度较大，行业整体面临“成本承压+技术追赶+竞争加剧”的多重挑战。

（七）宏观环境风险

2025 年，封装材料市场面临多重宏观风险，全球“双碳”目标下环保政策趋严，对碳排放及 VOCs 排放的限制持续收紧，企业需加大环保型胶粘剂研发投入，技术升级与合规成本显著增加；贸易保护主义抬头，欧美地区技术法规不断升级，为出口设置技术壁垒，阻碍海外市场拓展；环氧树脂、有机硅等关键原材料受地缘政治与极端天气影响，供应稳定性下降、价格波动加剧，给成本控制带来压力；同时，新技术与替代材料加速涌现，若未能跟进前沿趋势，现有产品可能被快速替代，叠加头部企业通过并购整合强化壁垒、挤压中小厂商空间，市场竞争格局面临重塑。

四、重大违规事项

2025年上半年度持续督导期间内，德邦科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	689,940,363.33	462,975,364.20	49.02%
利润总额	50,004,416.23	37,929,842.17	31.83%
归属于上市公司股东的净利润	45,573,498.99	33,710,727.09	35.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,287,232.18	28,857,375.54	53.47%
经营活动产生的现金流量净额	-18,228,037.28	184,143,829.32	-109.90%
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,298,056,652.11	2,294,036,142.65	0.18%
总资产	3,015,572,191.49	2,969,733,400.69	1.54%

报告期内，公司营业收入68,994.04万元，较上年同期增长49.02%，主要原因是：1）得益于市场环境整体向好，客户需求持续保持旺盛态势，公司各业务板块均实现稳定增长，原有业务为公司营业收入的增长贡献40.77%；2）报告期内，公司完成对苏州泰吉诺的并购，并于2025年2月起将其纳入合并范围，此次并购为营业收入增长贡献8.25%。

报告期内，公司利润总额 5,000.44万元，较上年同期增长31.83%，实现归属于上市公司股东的净利润4,557.35 万元，较上年同期增长35.19%，归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润4,428.72万元，较上年同期增长53.47%，主要原因是：1）报告期内收入规模增长带动利润增长；2）报告期内，公司完成对苏州泰吉诺的并购，并于2025年2月起将其纳入合并范围，公司盈利能力增强。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少109.90%，主要系报告期内，公司票据托收及贴现减少，同时为保障订单交付，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2025年上半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.24	33.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.24	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.20	55.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.98	1.49	增加0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92	1.28	增加0.64个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.47	5.70	减少0.23个百分点

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发优势

公司专注于高端电子封装材料的研发和产业化，深知高端电子封装材料的技术研发和新产品开发能力对企业持续经营的重要性，因此积极布局集成电路、智能终端、新能源等前沿领域。在国家高层次海外引进人才领衔的核心科研团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现技术突破，在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发体系，掌握核心技术并拥有完全自主知识产权。公司先后承担了“02专项”“国家重点研发计划”“A工程”和“高质量发展专项”等多个国家级重大科研项目。

公司始终坚持以自有技术建立自有品牌为目标，通过自主开发掌握了行业内领先的配方技术和工艺技术，并通过持续不断的改进，确保工艺的成熟稳定、产品性能的持续提升；通过持续的应用测试平台能力建设，不断提升客户对标以及新产品验证能力；通过关键材料的结构设计与自主合成，在确保成本优势的基础上提升公司核心竞争力；通过联合实验室共建、人才双向流动、标准共建等产学研活动的开展，实现企

业与高校的优势互补与协同创新。经过多年的技术积累，公司已建立起较为完备的高端电子封装材料产品体系，并与行业领先客户建立长期合作关系，凭借强大的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，进入到知名品牌客户的供货体系，并成为客户信赖的合作伙伴；公司紧跟行业趋势，通过持续的研发投入、人才的持续引入和创新，不断提升研发能力，巩固核心竞争力，保持了技术领先和产品迭代的优势，以应对日益激烈的市场竞争，实现可持续发展。

2025年上半年，公司主导的1项行业标准通过工信部组织的初审答辩，参与的2项国家标准已进入批准发布阶段；另有1项成果经由院士组成的专家组进行鉴定，达到国际领先水平；公司积极布局AI技术在新材料开发过程中的赋能应用，从数据的结构化管理以及数据库的建设为抓手，为后续AI数据分析及建模打下基础，提升研发效率。

（二）人才优势

经过多年在高端电子封装材料领域的研发深耕，公司已打造出一支高素质的核心管理团队与专业化的核心技术团队。在国家高层次海外引进人才的引领下，核心技术团队在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现了突破性进展，不仅构建起完整的研发生产体系，还掌握了一系列相关核心技术。核心管理团队则在战略规划、行业研判、人才培育、团队搭建、销售与市场拓展等方面具备深厚经验，这些在封装材料及相关行业积累的丰富阅历，为公司业务发展注入了全球先进乃至领先的视野。

公司重视后备人才引进与培养，针对应届新生开展“雏鹰计划”，通过6个月系统培训、实践及导师指导，助力其适应岗位、掌握技能、提升创新与协作能力，为公司注入活力并增强综合实力。本报告期内，研发人员达177人，同比增长29.20%，队伍稳步壮大；同时，公司建立结构化、多元化、体系化培养机制，员工综合素质提升，为保持核心竞争力筑牢人才根基。

（三）生产优势

公司具备快速的市场响应能力，公司下游应用领域存在较为明显的产品周期短、技术更新换代快、消费热点切换迅速的特点，这就要求上游材料供应商具有快速研发能力，以适配客户的产品工艺需求。

与此同时，公司所面向的客户主要为行业内知名品牌客户，下游客户对于供应链管理极为严格，一般要求即时发货，采购周期较短。公司已建造了行业领先的高端电子封装材料智能制造工厂，并拥有一批对行业、产品理解深刻的生产队伍，生产管理水平较高，能够配合客户的实时订单要求，迅速组织生产，实现供货。

公司秉承“客户的需求就是我们不懈的追求”的质量方针，致力于成为全球高端封装材料引领者愿景，围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控，并已通过ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系和QC080000 有害物质过程管理体系认证等管理体系的第三方认证。

（四）客户资源优势

高端电子封装材料，作为终端产品内部构件性能、稳定性及结构密封防护的关键要素，对于终端产品品质有着决定性的影响。因此，原材料的品质成为终端产品品牌商选择供应商时的核心考量因素，进入其供应商名录门槛颇高。随着下游高端应用领域的蓬勃发展，公司紧密围绕客户需求，开发细分产品，确保供应商地位的稳固，构筑起坚实的市场壁垒。多年来，公司凭借卓越的技术实力，成功将芯片固晶材料、晶圆UV膜等集成电路封装材料批量供应给国内知名封测企业，包括了华天科技、通富微电、长电科技、日月新等全球知名封测厂商；智能终端封装材料亦广泛应用于国内外知名品牌，包括苹果公司、华为公司、小米科技等智能终端领域的全球龙头企业；同时，宁德时代、中创新航、比亚迪、通威股份、阿特斯等新能源领域的知名企业亦成为公司的合作伙伴，这些优质客户资源为公司的发展提供了强有力的支撑。

为深化与客户合作，公司不断加强与终端应用品牌的技术交流，精准把握市场脉动和技术趋势，确保研发方向与产品迭代升级紧扣市场需求。公司依托核心技术，向客户提供高端电子封装材料及其解决方案，将技术与客户资源双重优势融合，进一步巩固市场地位，提升竞争力，引领行业发展。

（五）丰富的系统解决方案优势

公司在提供高性能产品的同时，更凭借扎实的技术研发实力和深厚的专有技术积累，为客户提供全方位的系统解决方案。公司多年积累的研发和应用数据库，能够实现更加精准高效研发。

从产品设计之初到生产应用培训，再到持续的售后服务与产品技术迭代，公司始终坚持以客户需求为核心，致力于提供一站式的高端电子封装材料解决方案。公司深入参与客户新产品设计的各个阶段，提供包括性能提升方案、材料配方设计、样品测试在内的全面服务。通过定制化服务，精准解决客户的个性化问题，实现与客户的协同作业，从而大幅提升客户满意度，并深化与下游客户的合作关系。在高端电子封装材料领域，产品性能受多种因素影响。因此，公司紧密与客户合作，共同设计出满足特定工艺参数、胶体特性、使用环境、老化参数和可靠性要求的产品解决方案。这种以客户需求为导向的服务模式，使公司能够不断优化产品性能，满足市场对高质量封装材料的复杂需求。

公司丰富的系统解决方案优势不仅体现在技术实力上，更体现在对客户需求的深度理解和满足上。这种优势不仅提升了客户的满意度和合作深度，更巩固了公司在高端电子封装材料领域的市场领先地位。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出及变化情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	37,773,528.79	26,369,663.24	43.25
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	37,773,528.79	26,369,663.24	43.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.47	5.7	降低0.23个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	不适用

(二) 研发进展

截至2025年6月30日，公司知识产权情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	9	822	355

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
实用新型专利	5	6	75	75
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	6	6
其他	0	0	0	0
合计	11	15	904	437

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76
支付发行费用	9,366,625.80
募集资金净额	1,487,483,248.88
减：募投项目投入	669,850,641.60
超募部分永久补充流动资金	553,530,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益	47,713,051.76
保函保证金退回	730,000.00
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	125,000,000.00
截止2025年6月30日募集资金专户余额	187,545,659.04

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410968	14,286.28
招商银行股份有限公司吴江支行	535902385410266	36,641,014.64
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410906	536,519.60
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410508	381,488.88

开户银行	账号	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司昆山支行	512910748910966	1,174.23
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000901666	11,775,485.77
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100862080	97,844.73
中国光大银行烟台经济技术开发区支行	38080188000258467	3,215,200.53
中信银行股份有限公司烟台自贸区支行	8110601011601495861	46,636.84
华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行	12656000000931613	9,804,238.11
招商银行股份有限公司烟台分行	535902385410616	66,245,890.43
中国光大银行股份有限公司烟台九隆支行	38090188000191019	7,055,426.37
招商银行股份有限公司烟台分行	535904836910706	51,730,452.63
合 计	/	187,545,659.04

（二）募集资金是否合规

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2025年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

单位：万股

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
解海华	董事长	1,509.03	498.94	2,007.97	14.12%
陈田安	董事、总经理、核心技术人员	311.94	-	311.94	2.19%

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
王建斌	董事、副总经理、核心技术人员	868.21	-	868.21	6.10%
林国成	董事	1,320.82	-	1,320.82	9.29%
王艺涵	董事	-	-	-	-
杨柳	董事	-	-	-	-
李明	独立董事	-	-	-	-
唐云	独立董事	-	-	-	-
宋红松	独立董事	-	-	-	-
庄恒东	监事	-	3.21	3.21	0.02%
陈丽	监事	-	6.68	6.68	0.05%
赵倩	监事	-	-	-	-
陈昕	副总经理	175.32	-	175.32	1.23%
于杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	2.10	389.75	391.85	2.75%
徐友志	副总经理、核心技术人员	1.70	-	1.70	0.01%
姜贵琳	核心技术人员	1.70	7.42	9.12	0.06%
潘光君	核心技术人员	-	3.71	3.71	0.03%
姜云	核心技术人员	1.24	0.74	1.98	0.01%
合计		4,192.07	913.43	5,105.50	35.89%

截至 2025 年 6 月 30 日，董事长解海华所持公司 75.00 万股股份存在被司法冻结的情形，公司已于 2023 年 6 月 2 日发布《烟台德邦科技股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-024）对相关信息进行披露。除此之外，上述其他人员持有的德邦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司
2025年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 王国胜
王国胜

李天雄
李天雄

